TiC 電極, TiSi<sub>2</sub> 電極と SiC 基板の Schottky ダイオード特性評価 Schottky diode characteristics of TiC and TiSi<sub>2</sub> electrodes on SiC substrates 東工大フロンティア研¹,東工大総理工², <sup>○</sup>鈴木智之¹, 岡本真里², 宗清修², 角嶋邦之², 片岡好則², 西山彰², 杉井信之², 若林整², 筒井一生², 名取研二¹, 岩井洋¹ Tokyo Tech. FRC¹, IGSSE² <sup>○</sup>T. Suzuki¹, M. Okamoto², S. Munekiyo², K. Kakusima², Y. Kataoka², A. Nishiyama², N. Sugii², H. Wakabayashi², K. Tsutsui², K. Natori¹, H. Iwai¹ E-mail: suzuki.t.cl@m.titech.ac.jp

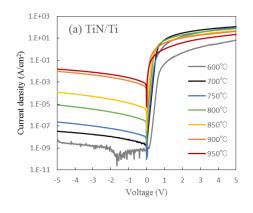
【はじめに】Siに比べて、SiCはバンドギャップが大きいため、耐電圧性能が高い[1]. さらに熱伝導率が高いため[2]、冷却しやすく高温でも使用できると期待される。SiCのショットキーバリアダイオードは金属とSiCを接触させて実現するが、界面反応による特性劣化が起こるため、最適な界面特性の調査と界面の制御が重要な課題である[3]. そこで、金属電極にSiあるいはCを含む電極としてTiSi2とTiCを選択し、ショットキーバリアダイオードを試作し、I-V特性評価を行った。

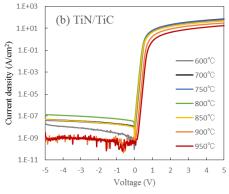
【実験方法】化学洗浄した n-SiC 基板に  $SiO_2$  の素子分離を行い,スパッタリングにより Ti,Si または Ti,C を相互に積層させた.その後,酸化防止膜として TiN を堆積し,RIE で電極を形成した.裏面電極は Ti/TiN 層を堆積し,オーミック電極とした.TiC または  $TiSi_2$  の形成のため  $N_2$  雰囲気中で熱処理を行い,処理温度ごとに I-V 特性を測定した.

【実験結果】作製した TiC, TiSi<sub>2</sub> および比較用の Ti と n-SiC のショットキーバリアダイオードの I-V 特性を Fig.1 に示した. 熱処理温度が高いとき電極に Ti を用いた場合に比べて, TiC や TiSi<sub>2</sub> を用いた方が逆方向電流の少ない安定したダイオード特性が得られた. この結果, TiC や TiSi<sub>2</sub> は SiC とのショットキー接合において,良好な熱安定性を持っており,不均一な界面反応を抑制できていることを示唆している. 今後,逆方向飽和電流や n 値に関しての詳細を調査する必要がある。

## 【参考文献】

- [1] H. Morkoç, et al., J. Appl. Phys., 76, 1363-1365 (1994)
- [2] Glen A. Slack, J. Appl. Phys., 35, 3464 (1964)
- [3] A. Itoh and H. Matsunami, phys. stat. sol. 162, 390 (1997)





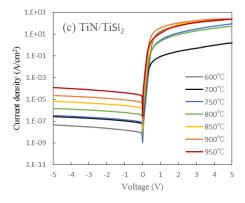


Fig.1 I-V characteristics of SiC SBD with (a) TiN/Ti,

(b) TiN/TiC and (c) TiN/TiSi<sub>2</sub>.